

TSMC construirá la primera fábrica de chips a 3 nm en Taiwán



Los fabricantes de semiconductores están centrados en llevar al mercado entre 2018 y 2019 los primeros chips creados en un nodo de 7 nm.

Aunque los procesadores de sobremesa están fabricados entre 10 y 14 nm actualmente, hay otros sectores que usan chips con tecnologías a punto de hacer el cambio, como el de los chips de memoria DRAM o NAND. Pero **TSMC** está yendo un poco más allá al **preparar el terreno para la llegada de los chips de 3 nm**.

La compañía ya ha elegido sitio para la construcción de una nueva fábrica que se centrará en este proceso a 3 nm, y será en el Parque Científico Tainan situado al sur de Taiwán. «TSMC reconoce la labor del Gobierno y está agradecida por la ayuda prestada para resolver los problemas de ubicación de esta fábrica, incluidos los de los terrenos, agua, electricidad y protección medioambiental». La compañía espera que la fábrica esté en funcionamiento en 2022 y que fabrique chips también a

5 nm.

La compañía también tiene casi listo su proceso a 7 nm, y espera que en 2018 la producción aumente de manera rápida. Usará en varios momentos del proceso capas creadas por luz ultravioleta extrema (UVE) pero no ha dado más detalles del mismo. A partir de ahí, se espera que use UVE en todos los procesos.

Fuente: geektopia.